

2024-2030年中国挠性覆铜板行业市场现状分析及 投资前景评估报告

报告大纲

一、报告简介

智研咨询发布的《2024-2030年中国挠性覆铜板行业市场现状分析及投资前景评估报告》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：<https://www.chyxx.com/research/202110/979561.html>

报告价格：电子版: 9800元 纸介版：9800元 电子和纸介版: 10000元

订购电话: 010-60343812、010-60343813、400-600-8596、400-700-9383

电子邮箱: sales@chyxx.com

联系人: 刘老师

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、报告目录及图表目录

为方便行业人士或投资者更进一步了解挠性覆铜板行业现状与前景，智研咨询特推出《2024-2030年中国挠性覆铜板行业市场现状分析及投资前景评估报告》（以下简称《报告》）。报告对中国挠性覆铜板市场做出全面梳理和深入分析，是智研咨询多年连续追踪、实地走访、调研和分析成果的呈现。

为确保挠性覆铜板行业数据精准性以及内容的可参考价值，智研咨询研究团队通过上市公司年报、厂家调研、经销商座谈、专家验证等多渠道开展数据采集工作，并对数据进行多维度分析，以求深度剖析行业各个领域，使从业者能够从多种维度、多个侧面综合了解2022年挠性覆铜板行业的发展态势，以及创新前沿热点，进而赋能挠性覆铜板从业者抢跑转型赛道。

挠性覆铜板是指以PI薄膜或聚酯薄膜等绝缘材料为基材，表面覆以满足挠曲性能要求的薄铜箔导体而得到的单面挠性覆铜板或双面挠性覆铜板。挠性覆铜板与刚性覆铜板相比，具有轻、薄和可挠性的特点，因此以挠性覆铜板为基板材料的FPC被广泛应用于手机、数码相机、汽车卫星方向定位装置、液晶电视、笔记本电脑等电子产品中。

挠性覆铜板按线路层数的不同可分为单面挠性覆铜板、双面挠性覆铜板和多面挠性覆铜板；按线路密度的不同可分为常规型挠性覆铜板和高密度型挠性覆铜板；按所选基材的不同可分为聚酯型挠性覆铜板、PI型挠性覆铜板和聚四氟乙烯型挠性覆铜板；按产品结构的不同可分为3L-FCCL和2层挠性覆铜板（2L-FCCL）。3L-FCCL又称为有胶黏剂型覆铜板，2L-FCCL又称为无胶黏剂型挠性覆铜板。

挠性覆铜板最早可追溯至1898年专利中出现的关于使用石蜡纸基板制作平面导体。1960年，美国工程师率先在热塑性薄膜上敷以金属箔，再蚀刻成型，从而在柔软电路板上形成线路图案。经过近半个世纪的发展，挠性覆铜板的应用范围越来越广泛，现已成为平板电脑、手机等消费级电子产品不可或缺的组成部分。

我国挠性覆铜板自20世纪80年代开始研发。从1987年原国营第704厂率先研发的覆铜箔聚酯薄膜和覆铜箔PI薄膜2种3层挠性覆铜板（3L-FCCL），到湖北化学研究院生产的挠性覆铜板逐渐形成一定规模的产能，见证着我国挠性覆铜板工业化的迅速发展。截至2022年，我国挠性覆铜板的总产能已接近1.52亿平方米，跻身于世界覆铜板生产大国行列。

2021年我国挠性覆铜板销售收入排名前六的企业分别是广东生益科技股份有限公司、长春化工（漳州）有限公司、山东金鼎电子材料有限公司、九江福莱克斯有限公司、华烁电子材料（武汉）有限公司。

随着科技的进步，电子产品的小型化、高精密要求越来越高。挠性覆铜板除了具有一般覆铜

板的电气连接、绝缘、机械支撑功能外，还可以反复弯曲，用挠性覆铜板制成的挠性印刷电路板可以使布线更加合理，节省安装空间，满足电子产品越来越轻薄短小的需求。

现阶段，挠性覆铜板的应用范围越来越广泛，已成为平板电脑、智能手机等消费级电子产品不可或缺的组成部分。由于电子产品市场快速发展，挠性覆铜板的市场规模不断扩大，特别是高性能的以聚酰亚胺薄膜为基材的挠性覆铜板，其市场需求量呈现快速增长的趋势。

《2024-2030年中国挠性覆铜板行业市场现状分析及投资前景评估报告》是智研咨询重要成果，是智研咨询引领行业变革、寄情行业、践行使命的有力体现，更是挠性覆铜板领域从业者把脉行业不可或缺的重要工具。智研咨询已经形成一套完整、立体的智库体系，多年来服务政府、企业、金融机构等，提供科技、咨询、教育、生态、资本等服务。

报告目录：

第一章 挠性覆铜板的品种及主要性能要求

第一节 按不同基材分类的FCCL品种

第二节 按不同构成分类的FCCL品种

第三节 按不同应用领域分类的FCCL品种

第四节 FCCL品种的其他分类

第五节 产品主要采用的标准及性能要求

一、FCCL管理体制

二、FCCL相关标准

三、FCCL的主要性能要求

第二章 挠性覆铜板的制造工艺法及其特点研究

第一节 三层型FCCL的制造工艺法及其特点

一、片状制造法

二、卷状制造法

第二节 二层型FCCL的制造工艺法及其特点

一、涂布法

二、溅射电镀法

三、层压法

四、三种工艺法生产的L-FCCL在性能、工艺特点方面的比较

第三节 FPC的技术发展方面

一、二层型FCCL已成品种发展的主流

二、FCCL近年在技术方面的进步

第三章 2019-2023年世界挠性覆铜板市场现状分析

第一节 2019-2023年世界挠性覆铜板产业发展概述

- 一、世界挠性覆铜板产业发展概述
- 二、世界FCCL市场规模及结构
- 三、世界挠性覆铜板价格竞争分析
- 四、FCCL原材料形态结构发生变化

第二节 2019-2023年世界挠性覆铜板区域市场分析

- 一、美国
- 二、日本
- 三、欧洲
- 四、韩国
- 五、中国台湾

第三节 2024-2030年世界挠性覆铜板产业发展前景预测分析

第四章 世界挠性覆铜板主要企业运营走势分析

第一节 新日铁化学株式会社

- 一、公司基本概况
- 二、公司经营与销售情况分析
- 三、公司竞争优势分析
- 四、公司国际化战略发展

第二节 宇部兴产株式会社

- 一、公司基本概况
- 二、公司经营与销售情况分析
- 三、公司竞争优势分析
- 四、公司国际化战略发展

第三节 台湾律胜科技股份有限公司

- 一、公司基本概况
- 二、公司经营与销售情况分析
- 三、公司竞争优势分析
- 四、公司国际化战略发展

第四节 新揚科技股份有限公司

- 一、公司基本概况
- 二、公司经营与销售情况分析
- 三、公司竞争优势分析

四、公司国际化战略发展

第五节 亚洲电材企业集团亚洲电材股份有限公司

- 一、公司基本概况
- 二、公司经营与销售情况分析
- 三、公司竞争优势分析
- 四、公司国际化战略发展

第六节 旗胜科技股份有限公司

- 一、公司基本概况
- 二、公司经营与销售情况分析
- 三、公司竞争优势分析
- 四、公司国际化战略发展

第七节 中国台湾台虹科技股份有限公司

- 一、公司基本概况
- 二、公司经营与销售情况分析
- 三、公司竞争优势分析
- 四、公司国际化战略发展

第五章 2019-2023年中国挠性覆铜板产业运营态势分析

第一节 2019-2023年中国覆铜板产业发展总体概述

- 一、中国覆铜板主要产品概述
- 二、中国覆铜板生产发展历程
- 三、中国覆铜板生产发展现状
- 四、中国覆铜板全面调研
- 五、中国覆铜板技改科研成果

第二节 2019-2023年中国挠性覆铜板产业发概况

- 一、中国挠性覆铜板产业发概况
- 二、中国挠性覆铜板生产情况分析
- 三、中国挠性覆铜板的产能与产量
- 四、中国挠性覆铜板企业销售状况

第三节 2019-2023年挠性覆铜板发展存在的问题与对策分析

第六章 2019-2023年中国挠性覆铜板相关市场调查

第一节 2019-2023年中国挠性印制电路业发展分析

- 一、柔性电路板相关概述
- 二、世界FPC产值及生产企业

三、我国FPC生产企业的现状

四、FPC多层挠性板的新技术

五、姜堰经济开发区柔性线路板项目开工

第二节 二层型挠性覆铜板在LCD的IC驱动用COF市场现状与发展

一、驱动IC用COF

二、驱动IC用COF挠性基板的性能特点及市场发展

三、COF挠性基板生产现状

第七章 2019-2023年中国印制电路板制造所属行业经济运行状况

第一节 2019-2023年中国印制电路板制造所属行业分析

一、2021年中国印制电路板制造所属行业发展概况

二、2022年中国印制电路板制造所属行业发展概况

第二节 2019-2023年中国印制电路板制造所属行业总体规模分析

一、2019-2023年中国印制电路板制造所属行业企业规模分析

二、2019-2023年中国印制电路板制造所属行业人员规模统计

三、2019-2023年中国印制电路板制造所属行业资产规模分析

四、2019-2023年中国印制电路板制造所属行业负债规模分析

五、2019-2023年中国印制电路板制造行业市场规模分析

第三节 2019-2023年中国印制电路板制造行业供需平衡分析

一、2019-2023年中国印制电路板制造行业产成品分析

二、2019-2023年中国印制电路板制造行业供给区域分布

三、2019-2023年中国印制电路板制造行业销售产值分析

四、2019-2023年中国印制电路板制造行业需求区域分布

第四节 2019-2023年中国印制电路板制造所属行业投资状况分析

一、2019-2023年中国印制电路板制造所属行业投资增长分析

二、2019-2023年中国印制电路板制造所属行业投资区域分布

三、2019-2023年不同规模印制电路板制造所属行业企业资产总额分析

四、2019-2023年不同性质印制电路板制造所属行业企业资产总额分析

第五节 2019-2023年中国印制电路板制造所属行业获利能力分析

一、2019-2023年中国印制电路板制造所属行业利润总额分析

二、2019-2023年不同规模印制电路板制造所属行业企业获利能力分析

三、2019-2023年不同性质印制电路板制造所属行业企业获利能力分析

四、2019-2023年中国主要省区印制电路板制造所属行业获利能力

第六节 2019-2023年中国印制电路板制造所属行业经营效益分析

一、2019-2023年印制电路板制造所属行业偿债能力分析

二、2019-2023年印制电路板制造所属行业盈利能力分析

三、2019-2023年印制电路板制造所属行业毛利率分析

四、2019-2023年印制电路板制造所属行业运营能力分析

第七节 2019-2023年中国印制电路板制造所属行业成本费用分析

一、2019-2023年印制电路板制造所属行业销售成本分析

二、2019-2023年印制电路板制造所属行业销售费用分析

三、2019-2023年印制电路板制造所属行业管理费用分析

四、2019-2023年印制电路板制造所属行业财务费用分析

第八节 2019-2023年中国印制电路板制造所属行业总体结构特征分析

一、2019-2023年印制电路板制造所属行业经济类型结构

二、2019-2023年印制电路板制造所属行业企业规模结构分析

三、2019-2023年印制电路板制造所属行业区域结构特征

第九节 2019-2023年中国印制电路板制造所属行业集中度分析

一、行业资产集中度分析

二、行业销售集中度分析

三、行业利润集中度分析

第八章 2019-2023年中国覆铜板及铜箔所属行业进出口数据监测分析

第一节 2019-2023年中国覆铜板及铜箔所属行业进口数据分析

一、2019-2023年中国覆铜板及铜箔所属行业进口数量情况

二、2019-2023年中国覆铜板及铜箔所属行业进口金额情况

第二节 2019-2023年中国覆铜板及铜箔所属行业出口数据分析

一、2019-2023年中国覆铜板及铜箔所属行业出口数量情况

二、2019-2023年中国覆铜板及铜箔所属行业出口金额情况

第三节 2019-2023年中国覆铜板及铜箔所属行业进出口均价分析

第四节 2019-2023年中国覆铜板及铜箔所属行业进出口国家及地区分析

一、2019-2023年中国覆铜板及铜箔所属行业进口国家及地区分析

二、2019-2023年中国覆铜板及铜箔所属行业出口国家及地区分析

第五节 2019-2023年中国覆铜板及铜箔所属行业进出口省市分析

一、2019-2023年中国覆铜板及铜箔所属行业进口省市情况

二、2019-2023年中国覆铜板及铜箔所属行业出口省市情况

第九章 中国覆铜板重点企业竞争力与关键性财务分析

第一节 广东生益科技股份有限公司

一、公司基本情况

二、企业经营情况分析

三、企业经济指标分析

四、企业盈利能力分析

第二节 金宝电子（中国）有限公司

一、公司基本情况

二、企业主要经济指标

三、企业偿债能力分析

四、企业盈利能力分析

第三节 金安国纪科技股份有限公司

一、公司基本情况

二、企业主要经济指标

三、企业偿债能力分析

四、企业盈利能力分析

第四节 广东汕头超声电子股份有限公司

一、公司基本情况

二、企业主要经济指标

三、企业偿债能力分析

四、企业盈利能力分析

第五节 山东金宝电子股份有限公司

一、公司基本情况

二、企业主要经济指标

三、企业偿债能力分析

四、企业盈利能力分析

第六节 无锡宏仁电子材料科技有限公司

一、公司基本情况

二、企业主要经济指标

三、企业偿债能力分析

四、企业盈利能力分析

第七节 建滔积层板（韶关）有限公司

一、公司基本情况

二、企业主要经济指标

三、企业偿债能力分析

四、企业盈利能力分析

第八节 华烁科技股份有限公司

一、公司基本情况

二、企业主要经济指标

三、企业偿债能力分析

四、企业盈利能力分析

第九节 广东超华科技股份有限公司

一、公司基本情况

二、企业主要经济指标

三、企业偿债能力分析

四、企业盈利能力分析

第十节 松下电子材料（苏州）有限公司

一、公司基本情况

二、企业主要经济指标

三、企业偿债能力分析

四、企业盈利能力分析

第十章 2019-2023年中国印刷电路板行业市场运行分析

第一节 2019-2023年中国印刷电路板行业发展概况

一、印刷电路板（PCB）分类及产业链

二、中国印刷电路板产量居世界首位

三、国内印刷线路板企业区域分布情况

四、印刷电路板技术发展水平及趋势

五、黄石是我国重要PCB产业基地

六、台湾柔性PCB公司在华东形成产业集群

七、重庆打造高技术印刷电路板产业高地

第二节 2019-2023年中国印刷电路板市场发展分析

一、2019-2023年中国印刷电路板产值规模

二、2019-2023年中国印刷电路板产品结构

三、中国印刷线路板市场集中度分析

四、中国印刷电路板市场需求特点分析

第三节 2019-2023年我国印刷电路板行业发展存在的主要问题分析

一、国内PCB配套产业还需进一步完善

二、产品集中于中低端成本转嫁能力弱

三、企业基础技术与开发水平薄弱

四、行业无序竞争产品定价能力有限

五、PCB企业环保投入需进一步加强

第四节 2024-2030年中国印刷电路行业发展对策分析

第十一章 2019-2023年中国挠性覆铜板用主要原材料业运行动态分析

第一节 挠性覆铜板用绝缘基膜--PI薄膜

- 一、绝缘基膜的生产方式
- 二、FCCL发展对绝缘基膜性能提出了更高的要求
- 三、世界FCCL用PI薄膜在品种和性能上的发展
- 四、世界挠性覆铜板用PI薄膜的市场需求情况

第二节 挠性覆铜板用导电材料

- 一、各类铜箔的品种及特征
- 二、压延铜箔
- 三、电解铜箔
- 四、FCCL发展对铜箔性能提出更高的要求

第三节 挠性覆铜板用胶粘剂

- 一、FPC用胶粘剂发展概述
- 二、丙烯酸酯粘合剂研究与应用的状况
- 三、环氧树脂粘合剂研究与应用的状况
- 四、聚酰亚胺粘合剂研究与应用的状况
- 五、世界FPC及FCCL用胶粘剂的主要生产厂家及品种

第四节 挠性覆铜板用覆盖膜

第十二章 2024-2030年中国挠性覆铜板行业发展前景预测分析

第一节 2024-2030年中国挠性覆铜板行业发展趋势分析

- 一、印刷电路板行业预测分析
- 二、对未来FPC技术发展预测
- 三、FPC发展对FCCL提出更高性能的要求

第二节 2024-2030年中国挠性覆铜板行业市场预测分析

- 一、覆铜板生产供给预测分析
- 二、挠性覆铜板供给预测分析
- 三、挠性覆铜板市场调查

第三节 2024-2030年中国挠性覆铜板所属行业盈利能力预测

第十三章 2024-2030年中国挠性覆铜板行业投资机会与风险分析

第一节 2024-2030年中国挠性覆铜板行业投资环境分析

第二节 2024-2030年挠性覆铜板行业投资机会分析

- 一、中国覆铜板行业投资情况分析

二、挠性覆铜板区域投资机会分析

三、挠性覆铜板行业投资吸引力分析

第三节 2024-2030年中国挠性覆铜板行业投资风险分析

一、宏观经济风险

二、市场竞争风险

三、原材料市场风险

四、技术研发风险分析

第四节 2024-2030年中国挠性覆铜板行业投资策略分析

图表目录：部分

图表1：2019-2023年全球挠性覆铜板市场规模走势

图表2：2019-2023年美国挠性覆铜板市场规模走势

图表3：2019-2023年日本挠性覆铜板市场规模走势

图表4：2019-2023年欧洲挠性覆铜板市场规模走势

图表5：2019-2023年韩国挠性覆铜板市场规模走势

图表6：2019-2023年中国台湾挠性覆铜板市场规模走势

图表7：2024-2030年全球挠性覆铜板产业市场规模预测

图表8：2019-2023年中国挠性覆铜板（FCCL）产量走势图

图表9：2019-2023年我国挠性覆铜板销售量走势图

图表10：2019-2023年我国挠性覆铜板销售量走势图

详细请访问：<https://www.chyxx.com/research/202110/979561.html>